

2026年中国HBM行业市场现状分析及未来趋势研 判报告

报告大纲

一、报告简介

智研咨询发布的《2026年中国HBM行业市场现状分析及未来趋势研判报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chyxx.com/research/1195346.html>

报告价格：电子版: 9800元 纸介版：9800元 电子和纸介版: 10000元

订购电话: 400-700-9383、010-60343812、010-60343813

电子邮箱: kefu@chyxx.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

报告导读：

高带宽内存（HBM）是一种基于3D堆栈工艺的图形DDR类型DRAM技术，通过TSV（硅通孔）和芯片堆叠架构实现高速数据传输与低能耗特性4.1，可满足AI的高带宽需求，已逐步成为AI加速卡（GPU、TPU等）的搭载标配，价值量占比最高且仍在进一步提升。高带宽内存（HBM）是AI时代的必备品，行业正处于快速发展阶段，人工智能、高性能计算等领域对HBM需求持续增长。2023年，全球HBM出货量1.5BGB，HBM产业收入为43.5亿美元；2024年全球HBM出货量2.8BGB，HBM产业收入为170亿美元；2025年，全球HBM出货量约4.1BGB，收入金额约307亿美元；预计2026年，全球HBM出货量有望达到5.7BGB，收入金额有望达到500亿美元。

为探究高带宽内存（HBM）行业变化趋势（怎么变）、用户需求（要什么）、投放选择（投向哪）、运营方法（如何投）及实践案例（看一看），智研咨询发布了《2026年中国HBM行业市场现状分析及未来趋势研判报告》。

观点抢先知：

行业定义及优势：高带宽内存（HighBandwidthMemory，HBM）是一种基于3D堆栈工艺的高性能半导体存储器，具备高带宽和能效，常被用于高性能计算、网络交换及转发设备等需要高存储器带宽的应用场合。HBM相比传统采用DRAM的方式，具有高带宽、高容量、低功耗和小尺寸四大优势。

行业相关政策：高带宽内存(HBM)是当前高性能计算领域最具革命性的内存技术之一。作为一种高性能内存解决方案，为人工智能技术的发展提供了强有力的支持。近年来，国家发布了一系列政策，为推动大力支持存储芯片行业发展，广泛应用于高性能计算、数据中心等领域的高带宽存储器行业将快速渗透。如《“十四五”数字经济展规划》《“十四五”国家信息化规划》等。

产业链核心节点：高带宽内存（HBM）行业产业链上游主要包括电解液、前驱体、IC载板、GMC等原材料，以及光刻机、刻蚀机、涂胶显影设备、薄膜沉积设备、离子注入设备、CMP设备等半导体设备；行业中游为高带宽内存（HBM）生产制造；行业下游主要应用于人工智能(AI)、互联网和数据中心、高性能计算、云计算等。

价值量占比：高带宽内存（HBM）是一种基于3D堆栈工艺的图形DDR类型DRAM技术，通过TSV（硅通孔）和芯片堆叠架构实现高速数据传输与低能耗特性4.1，可满足AI的高带宽需求，已逐步成为AI加速卡（GPU、TPU等）的搭载标配，价值量占比最高且仍在进一步提升。

HBM出货量：高带宽内存（HBM）是AI时代的必备品，行业正处于快速发展阶段，人工智能、高性能计算等领域对HBM需求持续增长。2023年全球HBM出货量1.5BGB，2024年全球HBM出货量2.8BGB，2025年全球HBM出货量约4.1BGB，预计2026年全球HBM出货量有

望达到5.7BGB。

收入金额：2023年全球HBM产业收入为43.5亿美元，2024年全球HBM产业收入为170亿美元，2025年全球HBM收入金额约307亿美元，预计2026年全球HBM收入金额有望达到500亿美元。

竞争情况：HBM需求旺盛，且长期被国外厂商垄断。2024年从市场格局看，海外厂商仍占据主导地位：SK海力士以53%的份额领先，且率先实现HBM3E量产；三星电子占比38%，正在进一步推进其HBM3E，并研究下一代HBM4，同时锁定重要的供应合同以满足AI和HPC的需求；美光科技目前份额为9%，美光科技正在加强其HBM组合研发，目标是2025年将市占率提升至20%以上。

国内企业布局：中国已有一批企业在HBM产业链的关键环节取得了重要突破，已经从材料、设备到芯片，撕开了一道口子，正加速构建自主可控的生态，国产化率有望提升。国内布局HBM的企业有长鑫存储、长电科技、通富微电、华天科技、深科技、晶方科技、华进半导体、中芯国际、长江存储、兆易创新、北京君正、澜起科技、聚辰股份等。

市场趋势：高带宽内存（HBM）作为下一代动态随机存取存储器（DRAM）技术，其结构使HBM的带宽（数据传输速率）远高于GDDR等传统内存解决方案。未来的AI内存版图将是异构多元的层级体系：HBM聚焦训练场景，PIM内存服务于高能效推理，专用片上内存架构适配超低延迟应用，新型堆叠DRAM与光子互连等技术也将在系统中占据一席之地。

报告相关内容节选：

报告目录：

第1章 HBM行业相关概述分析

1.1 存储芯片基本情况

1.2 HBM定义及结构

1.3 HBM技术优势

1.4 HBM行业进入壁垒

1.4.1 技术壁垒

1.4.2 资金、规模壁垒

1.4.3 人才壁垒

1.4.4 客户壁垒

1.5 HBM行业发展痛点

1.5.1 成本高昂

1.5.2 良率偏低

1.5.3 散热问题

1.5.4 技术难度高

第2章 HBM产业链及关键工艺分析

2.1 HBM产业链图谱

2.2 HBM产业封测端

2.2.1 HBM封装结构

2.2.2 TSV（硅通孔）技术

2.2.3 Bumping（凸块制造）技术

（1）凸点制造技术

（2）混合键合技术

2.2.4 Stacking（堆叠）技术

（1）MR-RUF技术

（2）TC-NCF技术

2.2.5 CoWoS技术

2.2.6 FC技术分析

2.3 HBM产业设备端

2.3.1 半导体设备市场规模

2.3.2 HBM生产制造所需设备

2.4 HBM产业材料端

2.4.1 电镀液

2.4.2 环氧塑封料（EMC）

2.4.3 光敏聚酰亚胺（PSPI）

2.4.4 封装基板

2.4.5 CXL

2.5 HBM产业应用端

2.5.1 人工智能市场现状

2.5.2 AI芯片市场现状

第3章 全球HBM市场现状分析

3.1 全球存储芯片行业发展现状

3.1.1 存储芯片发展历程

3.1.2 存储芯片市场规模

3.2 全球HBM行业发展历程

3.3 全球HBM市场规模

3.4 全球HBM市场结构

3.5 主要地区HBM发展现状

3.5.1 北美地区HBM发展现状

- (1) 美国相关政策
- (2) 市场规模

3.5.2 亚太地区HBM发展现状

- (1) 韩国相关政策
- (2) 日本相关政策
- (3) 市场规模

3.5.3 欧洲地区HBM发展现状

- (1) 相关政策
- (2) 市场规模

第4章 全球HBM市场格局分析

4.1 全球HBM企业竞争格局

4.2 全球HBM行业重点企业分布

4.2.1 韩国SK海力士

- (1) 公司基本情况
- (2) 公司经营业绩
- (3) 公司HBM业务布局
- (4) 公司HBM产线投资建设情况

4.2.2 韩国三星电子

- (1) 公司基本情况
- (2) 公司经营业绩
- (3) 公司HBM业务布局
- (4) 公司HBM产线投资建设情况
- (5) 公司HBM业务发展面临的挑战

4.2.3 美国美光科技

- (1) 公司基本情况
- (2) 公司经营业绩
- (3) 公司HBM业务布局
- (4) 公司HBM产线投资建设情况
- (5) 公司HBM业务发展面临的挑战

第5章 中国HBM行业发展现状分析

5.1 中国HBM行业政策分析

5.1.1 国家层面HBM行业相关政策

5.1.2 地区层面HBM行业相关政策

5.1.3 政策对HBM行业的影响

5.2 中国HBM行业市场规模

5.3 中国HBM行业技术动态

第6章 中国HBM行业竞争格局及重点企业分析

6.1 中国HBM行业企业格局

6.2 中国HBM行业重点企业分析

6.2.1 苏州赛腾精密电子股份有限公司

- (1) 公司基本情况
- (2) 公司经营业绩
- (3) 公司HBM相关产品布局
- (4) 公司未来发展计划

6.2.2 江苏雅克科技股份有限公司

- (1) 公司基本情况
- (2) 公司经营业绩
- (3) 公司HBM相关产品布局
- (4) 公司未来发展计划

6.2.3 通富微电子股份有限公司

- (1) 公司基本情况
- (2) 公司经营业绩
- (3) 公司HBM相关产品布局
- (4) 公司未来发展计划

6.2.4 紫光国芯微电子股份有限公司

- (1) 公司基本情况
- (2) 公司经营业绩
- (3) 公司HBM相关产品布局
- (4) 公司未来发展计划

6.2.5 江苏华海诚科新材料股份有限公司

- (1) 公司基本情况
- (2) 公司经营业绩
- (3) 公司HBM相关产品布局
- (4) 公司未来发展计划

6.2.6 拓荆科技股份有限公司

- (1) 公司基本情况
- (2) 公司经营业绩
- (3) 公司HBM相关产品布局
- (4) 公司未来发展计划

6.2.7 江苏联瑞新材料股份有限公司

- (1) 公司基本情况
- (2) 公司经营业绩
- (3) 公司HBM相关产品布局
- (4) 公司未来发展计划

6.2.8 武汉新芯集成电路股份有限公司

- (1) 公司基本情况
- (2) 公司HBM相关产品布局
- (3) 公司未来发展计划

第7章 中国HBM行业投资前景分析

7.1 中国HBM行业发展机遇

7.1.2 市场需求旺盛

7.1.2 政策大力扶持

7.1.3 企业加大研发投入

7.2 中国HBM行业发展面临挑战

7.2.1 海外对我国实施技术封锁

7.2.2 产业整体发展水平远落后于发达国家

7.3 中国HBM行业投资机会分析

7.3.1 产业链投资机会

7.3.2 其余投资方向

- (1) 主流DRAM产品供不应求
- (2) 国内利基型存储芯片厂商迎来发展机会

7.4 中国HBM行业投资风险分析

7.4.1 政策变动风险

7.4.2 贸易摩擦风险

7.4.3 技术研发不及预期风险

7.4.4 市场竞争加剧风险

7.4.5 AI技术发展不及预期风险

第8章 中国HBM行业发展趋势分析

8.1 HBM行业发展趋势分析

8.1.1 HBM将会迎来更广泛的应用

8.1.2 HBM性能不断优化

8.1.3 HBM产品走向“定制化”

8.1.4 HBM技术与其他技术融合发展

8.2 2026-2032年HBM行业市场规模预测

8.2.1 全球HBM市场规模预测

8.2.2 中国HBM市场规模预测

图表目录:

图表 1：存储器分类

图表 2：DDR、GDDR、LPDDR主要区别对比

图表 3：HBM结构图

图表 4：HBM在带宽、功耗方面具备明显优势

图表 5：HBM产业链

图表 6：HBM结构图及用到的封装工艺

图表 7：HBM 封装成本拆分

图表 8：TSV的工艺流程

图表 9：TSV工艺成本分布

图表 10：Bumping工艺流程

图表 11：使用微凸点连接和使用混合键合连接的HBM高度对比

图表 12：混合键合两种技术类型

图表 13：MR-MUF技术散热性能优异

图表 14：HBM堆叠技术对比

图表 15：2023-2025年全球CoWoS产能（单位：万片/月）

图表 16：2019-2025年全球半导体设备销售额（单位：亿美元）

图表 17：2022-2025年全球主要地区半导体设备销售额（单位：亿美元）

图表 18：HBM各环节设备需求

图表 19：2021-2025年全球半导体电镀化学品市场规模（单位：亿美元）

图表 20：2025年全球半导体电镀化学品市场规模分布

图表 21：截至2025年国内企业布局先进封装用电镀液情况

图表 22：2020-2023年全球半导体环氧模塑料(EMC)市场规模（单位：亿美元）

图表 23：CoWoS工艺RDL布线中的PSPI

图表 24：2019-2025年全球封装基板市场产值（单位：亿美元）

图表 25：2025年全球封装基板市场产值结构

图表 26：Type 3 CXL设备

图表 27：2021-2025年全球人工智能IT支出（单位：亿美元）

图表 28：国内外部分企业发布大模型参数

图表 29：2022-2025年全球AI芯片收入（单位：亿美元）

图表 30：DRAM带宽、互连带宽的增长远小于硬件计算能力的增长

图表 31：市场上主流GPU和存储类型

图表 32：2020-2025年全球存储芯片市场规模（单位：亿美元）

图表 33：2025年全球存储芯片市场结构

图表 34：HBM产品演进历程

图表 35：2022-2025年全球HBM需求量（单位：亿GB）

图表 36：2020-2025年全球HBM市场规模（单位：亿美元）

图表 37：2022-2025年全球HBM市场需求结构

图表 38：2020-2025年北美HBM市场规模（单位：亿美元）

图表 39：2020-2025年亚太HBM市场规模（单位：亿美元）

图表 40：2020-2023年欧洲HBM市场规模（单位：亿美元）

图表 41：2023年全球HBM企业竞争格局

图表 42：2016-2025年SK海力士经营业绩

图表 43：2025年SK海力士营收结构

图表 44：SK海力士HBM产品

图表 45：2016-2025年三星电子经营业绩（单位：万亿韩元）

图表 46：2022-2025年三星电子公司各业务营收情况（单位：万亿韩元）

图表 47：美光科技部门架构

图表 48：2019-2025财年美光科技营业收入及净利润（单位：亿美元）

图表 49：2021-2024财年美光科技各产品营收（单位：亿美元）

图表 50：美光科技HBM产品

图表 51：国家层面HBM行业相关政策

图表 52：地区层面HBM行业相关政策

图表 53：2020-2025年中国HBM市场规模（单位：亿元）

图表 54：中国HBM行业部分重点专利申请情况

图表 55：国内HBM产业链环节设计企业

图表 56：2021-2025年赛腾股份营收及净利润（单位：亿元）

图表 57：2022-2025年赛腾股份营收结构（单位：亿元）

图表 58：截至2025年末雅克科技主要产品产能

图表 59：2021-2025年雅克科技营收及净利润（单位：亿元）

图表 60：2022-2025年雅克科技营收结构（单位：亿元）

图表 61：2021-2025年通富微电营收及净利润（单位：亿元）

图表 62：2021-2025年通富微电集成电路封装测试营收及销量（单位：亿块，亿元）

图表 63：2021-2025年紫光国微营收及利润（单位：亿元）

图表 64：2022-2025年紫光国微营收结构（单位：亿元）

图表 65：2021-2025年紫光国微集成电路产销量（单位：亿颗）

图表 66：2021-2025年紫光国微研发投入（单位：亿元）

图表 67：2021-2025年华海诚科营收及净利润（单位：亿元）

图表 68：2025年华海诚科营收结构（单位：万元）

图表 69：2019-2025年华海诚科环氧塑封料产销量（单位：万吨）

图表 70：2021-2025年华海诚科研发投入（单位：万元）

图表 71：拓荆科技产品系列

图表 72：2021-2025年拓荆科技营收及净利润（单位：亿元）

图表 73：2025年拓荆科技营收结构（单位：亿元）

图表 74：2025年拓荆科技产品销量（单位：台）

图表 75：2021-2025年联瑞新材营收及净利润（单位：亿元）

图表 76：2025年联瑞新材产品营收及产销量（单位：万吨，亿元）

图表 77：武汉新芯业务结构

图表 78：2020-2025年中国人工智能核心产业规模（单位：万亿元）

图表 79：2021-2025年中国AI芯片市场规模（单位：万张）

图表 80：2026-2032年全球HBM市场规模预测

图表 81：2026-2032年中国HBM市场规模预测

更多图表见正文.....

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/1195346.html>